

车灯 | 电气系统 | 动力电池系统 | 智能座仓















轻量化+热管理,双重需求促进电车用胶工艺与技术的成长



节能减排压力和提升续航能力需求

10% - 减重

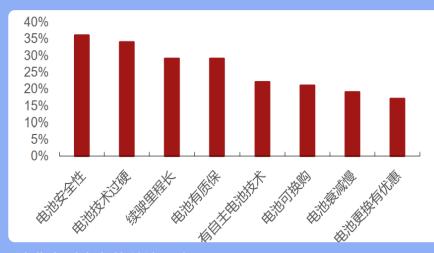
5%~10% 增加续航里程

 15%~20% <u></u> 节约电池成本

在保证汽车的强度、安全性和可靠性不降低的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量。汽车自身质量降低,能显著增益节能减排效果。 2025 年、 2030 年和 2035 年分别完成降低 15%、 25%和 35%的目标。

热管理需求

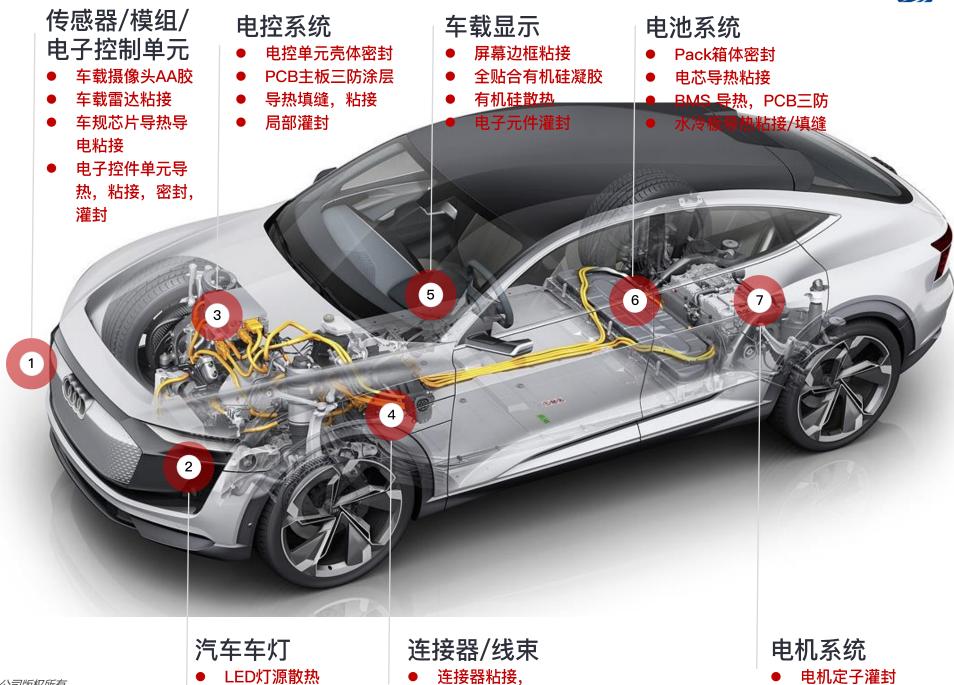
热管理系统能在电池温度较高时进行有效散热、 温度较低时有效预热、并减小电池组内温度差异、 抑制局部热区的形成,从而起到避免热失控的作用。





消费者对电车的关注因素



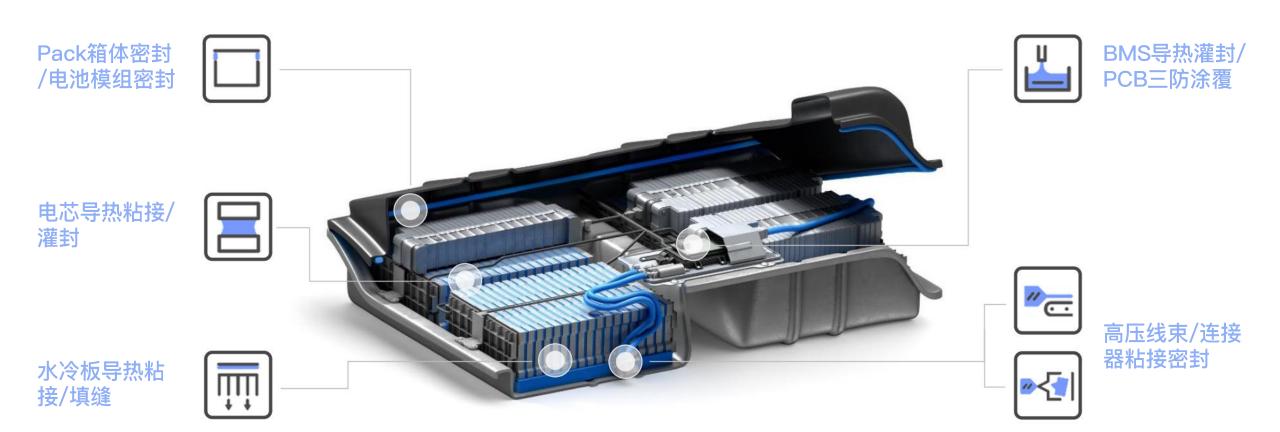


密封

车灯壳体粘接,密封

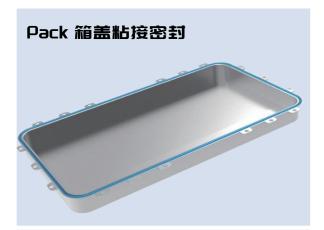


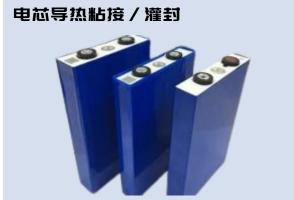
动力电池系统

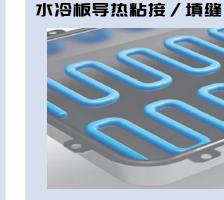




动力电池系统









推荐产品	H6319
类型	改性硅烷
固化	室温

推荐产品	H3032
类型	双组份聚氨酯
固化	室温/加热

推荐产品	H6035
类型	导热凝胶
导热率	3.5W

推荐产品	H3213/3214
类型	聚氨酯丙烯酸
固化	UV+湿气

应用特点:

与基材有良好的粘接性能,柔韧性 好,抗震动,抗冲击,耐高温,耐 老化,阻燃。

应用特点:

高导热率,对金属铝与PET具有很强的粘接性能,抗震动,抗跌落。

应用特点:

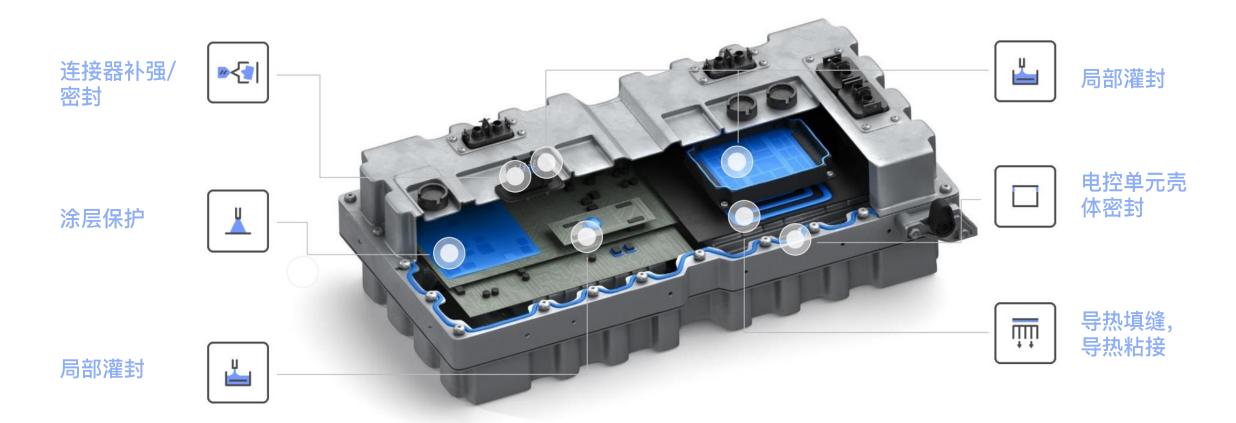
导热性能优异,具有良好的间隙填 充效果,耐高温老化,阻燃。

应用特点:

附着力好, 高绝缘性, 耐湿, 耐盐 雾, 耐化学腐蚀, 具有荧光检视



电控系统





电控/电机系统

连接器密封





电感/电机 灌封

元器件固定粘接



推荐产品	H6312
类型	有机硅
固化	室温

推荐产品	H2500
类型	环氧
固化	加热

推荐产品	H6315
类型	导热硅胶
导热率	0.9W

推荐产品	H3213/3214
类型	聚氨酯丙烯酸
固化	UV+湿气

应用特点:

与基材有良好的粘接与电气绝缘性 能,密封性能高,柔韧性好,抗震 动,抗冲击,耐高温,耐老化。

应用特点:

对铜质线圈具有优异的粘接密封效果, 电气绝缘, 耐高温, 可靠性好。

应用特点:

良好的导热性能, 粘接密封性能好, 耐高温, 耐老化, 绝缘, 阻燃。

应用特点:

附着力好, 高绝缘性, 耐湿, 耐盐 雾, 耐化学腐蚀, 具有荧光检视。



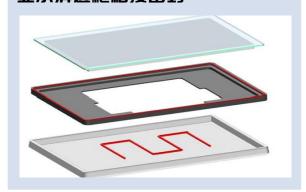
车载显示





车载显示

显示屏边框粘接密封



H6312/H6313

有机硅

室温



推荐产品	H6080
类型	有机硅
固化	室温/加热

应用特点:

推荐产品

类型

固化

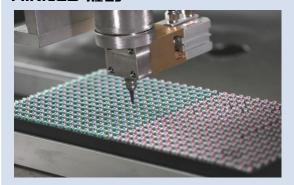
与基材有良好的粘接与电气绝缘性 能,密封性能高,柔韧性好,抗震 动,抗冲击,耐高温,耐老化。

应用特点:

LCD全贴合

双组份1: 1, 高透过率, 低应力保护, 耐UV, 耐候性极佳

MINILED 灌封

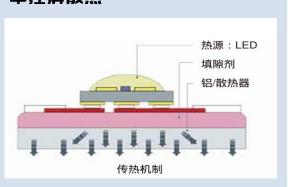


推荐产品	H2086/H2087
类型	环氧
固化	热固

应用特点:

低粘度,低温热固,自流平,低应力,耐候,耐湿热老化。

中控屏散热



推荐产品	H6020/H6130P
类型	有机硅
导热率	2–3W

应用特点:

导热性能优异,具有良好的间隙填 充效果,耐高温老化,阻燃。



车灯

车灯透镜与底壳粘接密封



推荐产品 H6312/H6322 类型 有机硅

室温

应用特点:

固化

与基材有良好的粘接与电气绝缘性 能,密封性能高,柔韧性好,抗震 动,耐高低温,耐老化。

车灯透镜与底壳粘接密封



推荐产品	H3200B
类型	PUR
固化	湿气

应用特点:

初粘强度高,湿气固化后,剪切和 剥离强度高,耐湿热老化和冷热冲 击。

灯体与基座减震密封



推荐产品	H3205
类型	聚氨酯发泡
固化	热固

应用特点:

单组份,低温快固,3-5倍发泡率,对金属塑料底材具备优秀的附着力,抗震动,耐老化,替代泡棉胶带。

车灯LED散热



推荐产品	H6035/H6130P
类型	有机硅
导热率	3W

应用特点:

导热性能优异,具有良好的间隙填充效果,耐高温老化,阻燃。



传感器/模组/电子控制单元

车载摄像头	应用	推荐产品	类型	固化
	摄像头AA胶	H2051/H2052	UVH双重固化 环氧结构胶	UV+热固
	芯片DA	H2159/H2122	环氧胶	热固
	芯片四角固定	H5224B	光固化结构胶	UV
	FPC补强/元件粘接	H5064	双重固化 UV胶	UV+湿气
	PCB焊点保护	H5107	光固化胶	UV

	车载IGBT模块	应用	推荐产品	类型	固化
硅胶 键合引线 FRD_IGBT	堰 功率芯片导热导电互连	H2366	有压烧结银	热固	
	功率芯片导热导电互连	H2376	有压烧结铜	热固	
基板	國党屋 2	IGBT灌封	H6085S	有机硅凝胶	热固
热量传输	IGBT灌封	H2085	双组份环氧导热灌封	室温/热固	



创瑾科技(TRUMJIN®)位于湖南长沙,集研发、生产、销售于一体,立足电子胶粘剂领域,致力于更高性能的胶粘材料的研究与开发。公司拥有一支由工程院士领衔的技术团队,孵化中科院及国内各大高校科研成果,为全球客户提供专业的产品和技术支持。创瑾科技秉承"匠心、创新、智慧,至美"的品牌理念,矢志推动国产高端电子胶粘剂行业的成长和发展。产品涵盖粘接、密封、三防、灌封、导热、导电六大应用领域,技术研究涉及环氧、丙烯酸、聚氨酯、硅胶四大方向,以电子制造行业的核心胶粘需求为出发点,通过应用市场的横向布局、技术研究和成果转化的纵向探索相结合的模式,快速响应并及时满足市场需求。



湖南创瑾科技有限公司

Hunan Trumjin Technology Co.,Ltd

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路中国长沙智能终端产业园5号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com







